公司代码:688233　　公司简称:神工股份

锦州神工半导体股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-6,910.98万元,截至2023年12月31日,公司累计未分配利润为人民币33,443.93万元。根据《锦州神工半导体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,公司当年盈利及累计未分配利润为正数时进行利润分配。

公司充分考虑整体盈利水平以及实际发展需求,为更好地维护全体股东的长远利益,2023年度公司拟不进行利润,不派发现金红利,资本公积不转增股本,不送红股。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	神工股份	688233	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	袁欣
办公地址	辽宁省锦州市太和区中信路46号甲
电话	+86-416-711-9889
电子信箱	info@thinkon-cn.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

报告期内,公司克服下游需求周期性下滑的不利影响,在营业收入大幅下滑的不利条件下,严控成本,加强管理,继续维持了大直径硅材料产品较高的毛利水平。两大业务“硅零部件”和“半导体大尺寸硅片”,公司的研发投入符合市场需求,市场推广取得显著进展,在国产半导体供应链中占据了有利位置,在下游客户面临技术出口管制导致的供应链风险时发挥了独特的支撑作用,进一步打开了市场空间;原有“大直径硅材料”业务,产能经稳健扩充继续保持全球领先,全球细分市场领先优势进一步巩固。主要情况分别说明如下:

1)大直径硅材料

这一业务板块的产品,按直径覆盖了从14英寸至22英寸所有规格,主要销售给日本、韩国等国的硅零部件加工厂,因此也可称之为“集成电路刻蚀用大直径硅材料”。该产品具有国际竞争力,在技术、品质、产能和市场占有率等方面处于世界领先水平,也是公司的主要营业收入来源。

报告期内,公司大直径硅材料产品生产情况稳定,产能逐步提升中;产品结构继续优化升级,利润率较高的16英寸以上产品收入占比进一步提升,从2022年度的28.95%提升至2023年度的39.01%,对该业务保持平稳的整体毛利率水平有较大贡献。

2)硅零部件

上述“大直径硅材料”,经过切片、磨片、腐蚀、打微孔、形状加工、抛光、清洗等一系列精密加工后,最终做成等离子刻蚀机用硅零部件。公司是具备“从晶体生长到硅电极成品”完整制造能力的一体化厂商,拥有全球领先的大直径硅材料晶体制造技术,是等离子刻蚀机设备厂家硅零部件产品的上游材料供应商。硅电极产品具有“品种多、批量小”的特点,具体产品消耗量依集成电路制造厂商的等离子刻蚀机种类、腔体结构、数量和具体制造工艺所决定,尺寸越大,设计要求越复杂的产品,对加工能力要求越高,毛利率相对越高。

根据公司自主调研数据,目前国内12英寸集成电路制造厂约有50万片/月的产能,因此合理估计国内硅零部件市场已有18亿元人民币/年以上的市场规模。其中,国内集成电路制造厂客户的自主委托定制改进硅零部件市场需求为15亿元人民币/年;另外,中国本土等离子刻蚀机原厂的OEM硅零部件市场需求为3亿元人民币/年。预计未来3-5年,国内硅零部件市场的国产化率将从最初的5%,逐步达到50%以上,考虑到当前国际政治经济形势,该进程有望加速。

报告期内,硅零部件产品实现收入达到3,763.90万元以上,实现翻番。国内集成电路制造厂商客户方面,公司已经获得更多评估认证机会,在数家12英寸集成电路制造厂商已有数十个料号获得评估认证通过结果。目前公司硅零部件产品整体销售数量不断攀升,其中加工难度较大、价值较高的产品销售占比逐步扩大。

随着美国对华技术出口管制政策收紧,美系半导体制造设备原厂应为中国本土集成电路制造厂商已安装机台提供的备件、维保服务受到阻碍,供应链风险加速暴露。中国本土集成电路制造厂商客户对硅零部件产品的自主委托定制改进需求持续增加,评估认证积极性增强,认证速度提升。

公司配合国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品,适用于12英寸等离子刻蚀机,已有十余个料号通过认证并实现批量供货,同时能够满足刻蚀机设备原厂不断提升的技术升级要求。公司产品的认证应用范围,已经从研发机型扩展至某些成熟量产机型。

为保证未来客户批量订单的及时交付,公司子公司福建精工半导体股份有限公司已经在泉州、锦州两地扩大生产规模,实现了较快速度的产能爬升。

3)半导体大尺寸硅片

公司以生产技术门槛高,市场容量比较大的轻掺低缺陷抛光硅片(正片)为目标,目前从全球市场8英寸硅片总需求上看,轻掺硅片占全部需求的70-80%左右;在12英寸硅片总需求中,轻掺硅片占比几近100%。公司已掌握了包含8英寸半导体级硅片在内的晶体生长及硅片表面精密加工等多项核心技术。具体包括:晶体生长稳态化控制技术、低缺陷单晶生长技术、高良率切片技术、高效化学腐蚀及清洗技术、超平整度研磨抛光技术、硅片检测评价技术、硅片表面微观线性损伤控制技术、低酸量硅片表面清洗技术、线切割过程中硅片翘曲度的稳定性控制技术、针对8英寸抛光片表面雾化现象的控制加工技术、硅片表面超平坦抛光技术、高温氩气退火技术、酸腐蚀平坦度控制技术、硅片表面颗粒清洗技术等。

公司分阶段实施的工艺优化,即通过工艺和热场结构的变化,加强对晶体内氧含量的控制,以适配不同规格硅片的相应技术要求,能够实现从晶体生长端到硅片加工端的协同效应。硅片加工技术方面,公司研发了控制硅片表面平坦度的多项核心技术,硅片正片的平坦度指标持续改善,产出率逐步提高,能够持续满足下游客户需求。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

在大直径硅材料领域,凭借多年的技术积累及市场开拓,公司在产品成本、良品率、参数一致性和产能规模等方面均具备较为明显的竞争优势,细分市场占有率不断上升,市场地位和市场影响力不断增强。目前公司已扎根于分工严密的国际半导体供应链中,大直径硅材料直接销售给日本、韩国等国的知名硅零部件厂商。后者的产品销售给国际知名刻蚀机设备厂商,例如美国泛林集团(Lam Research)和日本东电电子(Tokyo Electron Limited, TEL),并最终销售给三星和台积电等国际知名集成电路制造厂商。

报告期内,公司大直径硅材料产品生产情况稳定,产能得到稳健扩充;产品结构继续优化升级,利润率较高的16英寸以上产品收入占比上升至39.01%;成本方面,2023年以来,原始多晶硅原料价格下降并回复至历史价格中枢,随着公司原有库存原材料消耗,公司大直径硅材料产品的原始多晶硅原料成本将逐渐降低。公司继续保持细分市场竞争优势。

在硅零部件领域,公司拥有一南一北两个厂区,配合国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品,正在从研发机型扩展至某些成熟量产机型;与数家12英寸集成电路制造厂商接洽,已有数十个料号获得评估认证通过结果。

在半导体大尺寸硅片领域,公司核心技术团队在日本有多年的轻掺低缺陷硅片生产经验。公司是国内极少数专注于轻掺低缺陷技术路线的硅片厂商,具备替代海外供应商向国内集成电路制造厂商供应高质量硅片的潜在实力。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)半导体终端需求结构性变化对产品定制研发能力提出更高要求

报告期内,全球半导体市场呈现结构性变化,SEMI预计,2024年全球半导体市场的增长来自前沿的逻辑芯片和代工、生成式人工智能、高性能计算等应用的增长以及芯片在终端领域的需求。一方面,生成式人工智能应用快速迭代发展,算力相关存储、逻辑芯片热销,但其对市场整体带动仍有限;另一方面,尽管AI+PC、AI+手机的初代产品已经面世并引起广泛关注,但消费电子市场能够取代智能手机的下一代主机产品尚不明确。因此,下游市场的不确定性增加了上游企业对趋势的判断难度,同时也对企业的产品定制研发能力提出更高要求,唯有紧跟市场变化并推陈出新的企业才能快速反应、赢得先机。

台积电于2024年1月公布的营运绩效报告显示,“高性能计算”和“智能手机”两大技术平台占公司2023年总收入的比重为43%和38%,高性能计算已经取代智能手机,成为该公司最重要的年度收入来源,且占比同比继续提升。从全年增长来看,高性能计算和车用电子技术平台同比增长为0%和15%,智能手机、物联网和消费电子同比下滑8%、17%和16%。三星电子于2024年1月表示,2023年销售额同比下降14.3%,营业利润同比下降84.9%,预计DRAM和NAND库存将在2024年第一季度后和2024年上半年内恢复至正常范围。SK Hynix认为,随着面向人工智能的存储器需求加剧,未来的竞争将在于通过及时、合理的价格为客户提供所需的价值来维持销售额和利润增长,而不是仅仅基于数量的市场份额。人工智能时代的来临,正在催生多元化、定制化的存储芯片市场。

从中国本土市场来看,SEMI预计2024年全球将有35座新晶圆厂运营,其中中国计划运营16座。中国芯片制造商在2023年月产能同比增长12%至760万片;2024年月产能将同比增加13%至860万片。中芯国际于2024年2月表示,整个市场来看,需求复苏的强度尚不足以支撑半导体全面强劲反弹,从地缘政治出发的产能建设越来越多,加上宏观经济周期、消费滞后,晶圆代工业的利用率在短时间内很难回到前几年的高位。但是,中国是世界上最大的芯片应用市场,在地生产具有更大的机会,公司将密切关注供应链的安全性、可靠性、韧性,不遗余力地推进供应链的多元化和国产化。

(2)芯片制程日趋缩小对刻蚀工艺和大直径硅材料制造技术提出更高要求

报告期内,国际先进集成电路制造厂商的先进制程工艺取得突破:三星电子计划于2025年实现2nm产线量产;台积电计划扩产3nm制程产线,2nm制程芯片目标定于2025年量产;英特尔计划于2027年开发出1.4nm制程技术。半导体加工制程不断进步,12英寸集成电路产品的设计线宽越来越窄,因此沟槽也相应变窄,需要更高的刻蚀精度。更高的刻蚀精度,对12英寸硅片表面的温度、刻蚀气体浓度、材料性质提出更高的均匀性要求。采用更大的腔体和更大的上电极、下电极,更容易确保12英寸硅片面内各项工艺对均匀性的要求。因此,目前国际领先刻蚀机厂商的最新机型,都在向着大型化方向发展。随着以上技术工艺发展,更大尺寸的硅电极及其所需的上游材料一一更大直径的大直径硅材料(16英寸以上)的需求也将随之增加。

此外,以HBM为代表的人工智能所需算力芯片所发展竞争日趋激烈,SK Hynix、三星、美光都在2024年年初推出各自的新一代HBM产品。三维堆叠结构的HBM产品对TSV工艺提出更高要求,刻蚀工艺的精准控制和优化对于确保TSV的准确形成和可靠性至关重要,对刻蚀技术和刻蚀应用数量提出更高要求。SK Hynix和三星都提出计划在年内增加TSV产能。

目前,公司16英寸以上大直径硅材料产品的技术和产能在全球市场拥有竞争优势;公司将持续研发针对体积较大、设计难度较高的12英寸高端制程所需硅零部件产品。

(3)全球主要经济体芯片产业竞争所带来的风险与机遇并存

报告期内,美国施行集成电路产业支持政策,对华技术出口管制措施继续升级。2023年3月14日,美国国务院宣布为《芯片和科学法案》(CHIPS and Science Act)项目拨款1亿美元,用于支持半导体和安全信息和信息通信技术。该法案主要内容包含财政税务补贴支持,刺激多在美国本土有或者曾经有制造部分的行业头部企业,包括英特尔、美光和安森美等重新回到美国研发与生产。2023年10月17日,美国商务部工业和安全局(BIS)更新了“先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则”的三项内容,对2022年10月7日规则的修改和强化,对人工智能相关芯片、半导体制造设备的对华出口限制进一步收紧,并将多家中国实体增列入出口管制“实体清单”。

此外,美国、欧盟、韩国、日本都已在实施数十亿至数百亿美元不等的半导体投资补贴政策。宏大的发展目标及巨额的公共资金支持,正在改变全球半导体产业的资源流向和投资节奏。2024年2月,台积电与日本索尼等公司合资的熊本工厂投产,第二座工厂预计2026年投产,与此同时,美国亚利桑那工厂却宣布延期至2025年投产。芯片制造产能对本土供应链的要求极高,并非仅凭政策和补贴能够一蹴而就,公司所在的东亚中日韩三国的产业链优势难以撼动。

全球主要经济体面向芯片制造领域的产业政策竞争持续加剧,带来的风险与机遇并存:一方面,公司的中国本土客户向美国进口先进设备的难度大大增加,产品研发和产能扩张受到延缓和阻碍;另一方面,随着对华技术出口管制政策收紧,下游本土客户对国产供应商的评估认证积极性有所增强,速度有所提升,也为公司的硅零部件和半导体大尺寸硅片产品提供了更大的成长空间和更强的成长动能。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,933,422,436.15	1,759,658,594.62	9.87	1,494,391,913.36
归属于上市公司股东的净资产	1,761,794,579.03	1,573,266,430.97	11.98	1,418,104,401.42
营业收入	135,033,152.23	539,236,503.68	-74.96	503,551,819.77
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	129,443,827.09	502,659,382.34	-74.25	485,808,694.21
归属于上市公司股东的净利润	-69,109,826.01	158,141,626.89	-143.70	220,992,902.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,555,263.79	155,541,778.43	-146.00	216,929,864.34
经营活动产生的现金流量净额	82,209,545.12	130,146,507.24	-36.83	189,125,285.87
加权平均净资产收益率(%)	-4.31	10.84	减少15.15个百分点	16.80
基本每股收益(元/股)	-0.43	0.99	-143.43	1.38
稀释每股收益(元/股)	-0.43	0.99	-143.43	1.38
研发投入占营业收入的比例(%)			增加9.34个百分点	

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	52,135,489.56	26,699,333.87	40,345,177.56	15,853,151.24
归属于上市公司股东的净利润	-12,083,269.44	-11,616,176.68	-17,505,446.82	-27,904,933.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,146,914.57	-12,521,146.70	-17,877,665.32	-28,009,537.20
经营活动产生的现金流量净额	36,567,034.61	1,310,232.90	-2,950,402.79	47,282,680.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,484
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,667
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
更多亮照明有限公司	0	37,003,560	21.73	0		无	0	境外法人
矽康半导体科技(上海)有限公司	0	35,550,301	20.87	0		无	0	境内非国有法人
北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)	-2,300,000	7,641,705	4.49	0		无	0	境内非国有法人
温州晶融企业管理合伙企业(有限合伙)	0	2,873,733	1.69	0		无	0	境内非国有法人
626投资控股有限公司	-1,600,000	2,542,715	1.49	0		无	0	境外法人
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合	0	2,037,108	1.20	0		无	0	其他
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	1,823,884	1,823,884	1.07	0		无	0	其他
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	1,691,721	1,691,721	0.99	0		无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	1,671,020	1,671,020	0.98	0		无	0	其他
王光坤	-4,400	1,657,255	0.97	0		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		矽康半导体科技(上海)有限公司、温州晶融企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区旭捷投资管理合伙企业(有限合伙)已签署一致行动协议。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权数增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	更多亮照明有限公司	37,003,560	0	37,003,560	21.73	0	无
2	矽康半导体科技(上海)有限公司	35,550,301	0	35,550,301	20.87	0	无
3	北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)	7,641,705	0	7,641,705	4.49	-2,300,000	无
4	温州晶融企业管理合伙企业(有限合伙)	2,873,733	0	2,873,733	1.69	0	无
5	626投资控股有限公司	2,542,715	0	2,542,715	1.49	-1,600,000	无
6	易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合	2,037,108	0	2,037,108	1.20	0	无
7	招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	1,823,884	0	1,823,884	1.07	1,823,884	无
8	招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	1,691,721	0	1,691,721	0.99	1,691,721	无
9	中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	1,671,020	0	1,671,020	0.98	1,671,020	无
10	王光坤	1,657,255	0	1,657,255	0.97	-4,400	无
合计	/	94,493,002	0	94,493,002	/	/	/

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入13,503.32万元,同比下降74.96%;归属于上市公司股东的净利润-6,910.98万元,同比下降143.70%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688233　证券简称:神工股份　公告编号:2024-010

锦州神工半导体股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2024年3月29日通过现场的方式召开。会议已于2024年3月18日通知。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席哲凯召集和主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《锦州神工半导体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议,我们作为公司监事认为:

1、公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作,公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。能够客观、真实地反映公司2023年度的经营情况。

2、经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2023年度财务报告客观、真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

3、我们保证和承诺,公司2023年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司2023年年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司2023年年度报告》及《锦州神工半导体股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

经审议,我们作为公司监事认为:

公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,编制了《锦州神工半导体股份有限公司监事会2023年年度工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经审议,我们作为公司监事认为:

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,综合公司2023年年度经营及财务状况,公司编制了《锦州神工半导体股份有限公司2023年财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

经审议,我们作为公司监事认为:

2023年度公司拟不进行利润,不派发现金红利,资本公积不转增股本,不送红股。本年度不进行现金分红,主要原因为2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为负,不符合《公司章程》现金分红条件的相关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

经审议,我们作为公司监事认为:

2023年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合公司当前生产经营实际情况需要,在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:本议案,全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议,我们作为公司监事认为:

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议,我们作为公司监事认为:

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,我们作为公司监事认为:

公司拟使用不超过40,000.00万元(含本数)人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自董事会会议审议通过之日起不超过12个月(含12个月),在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于终止实施2022年限制性股票激励计划的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于修订(公司章程)并修订制定公司部分管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于修订(公司章程)并修订制定公司部分管理制度的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

(十三)审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司监事会

2024年3月30日

证券代码:688233　证券简称:神工股份　公告编号:2024-011

锦州神工半导体股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度利润分配方案为:不进行利润分配,同时不以资本公积转增股本。

● 公司2023年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 本年度不进行现金分红,主要原因为2023年度实现归属于上市公司股东的净利润负,不符合《锦州神工半导体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)现金分红条件的相关规定。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-6,910.98万元,截至2023年12月31日,公司累计未分配利润为人民币33,443.93万元。根据《锦州神工半导体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,公司当年盈利及累计未分配利润为正数时进行利润分配。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,公司充分考虑整体盈利水平以及实际发展需求,为更好地维护全体股东的长远利益,2023年度公司拟不进行利润,不派发现金红利,资本公积不转增股本,不送红股。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

根据相关法律法规、规范性文件及《锦州神工半导体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为负,不符合现金分红条件的相关规定,因此不进行利润分配。我们认为该利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等有关规定及公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

(三)监事会意见

2023年度公司拟不进行利润,不派发现金红利,资本公积不转增股本,不送红股。本年度不进行现金分红,主要原因为2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为负,不符合《公司章程》现金分红条件的相关规定。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码:688233　证券简称:神工股份　公告编号:2024-009

锦州神工半导体股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2024年3月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2023年3月18日送达全体董事。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司2023年年度报告》及《锦州神工半导体股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

董事会审议同意《锦州神工半导体股份有限公司2023年度董事会工作报告》的内容,并分别听取了《锦州神工半导体股份有限公司2023年度独立董事述职报告》和《锦州神工半导体股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司2023年度独立董事述职报告(李仁玉)》《锦州神工半导体股份有限公司2023年度独立董事述职报告(吴粒)》《锦州神工半导体股份有限公司2023年度独立董事述职报告(刘竞文)》及《锦州神工半导体股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于(2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告)的议案》

公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,在为公司提供审计服务期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备为公司提供2023年度审计服务的能力和经验。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(五)审议通过《关于(董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联独立董事李仁玉先生、吴粒女士、刘竞文先生回避表决。

(六)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,综合公司2023年年度经营及财务状况,公司编制了《锦州神工半导体股份有限公司2023年财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

公司2023年度利润分配方案为:不进行利润,不派发现金红利,资本公积不转增股本,不送红股。本年度不进行现金分红,主要原因为2023年度实现归属于上市公司股东的净利润负,不符合《公司章程》现金分红条件的相关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(九)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

2023年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合公司当前生产经营实际情况需要,在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到